Samsung s5 sostituzione Pmic (pm8917)

Rimozione

1 rimuovere completamente la scheda madre dal telefono

2 fissare il MB utilizzando una morsa o un altro strumento e proteggere le parti circostanti da calore in eccesso coprendo con del nastro Kapton o schermatura metallica

3 utilizzare set aria calda a 120deg basso flusso d'aria e utilizzando un ago o una pinzetta tagliente rimuovere qualsiasi adesivo / colla nero intorno ai bordi della ic completamente prendere tutto il tempo possibile per ottenere i migliori risultati.

4 put flusso sopra e attorno ai bordi della ic wifi per favorire la dispersione del calore quindi utilizzando un ugello 6 e l'aria calda a 380deg (portata d'aria al minimo) applicare calore alla ic in modo circolare per circa test 10/12 min con un metallo selezionamento costantemente fino il chip è liberamente muove quindi rimuovere il dal pcb.

5 rimuovere eventuali tracce di saldatura e pulire i pad sul MB utilizzando flusso e uno qualsiasi dei molti metodi attualmente dimostrato sul web personalmente uso treccia impregnata di flusso supplementare fare molta attenzione a non staccare qualsiasi pad sul pcb

6 si applicano flusso ai pad sul ic sostituzione quindi posizionare il ic sotto uno stencil calore diretto e applicare pasta saldante piombo ai pad che dovrebbero essere visibili. Usando il calore 300deg e il flusso d'aria minimo, riscaldare la saldatura fino a sfociare circa 15 a 30 secondi (pasta o palle piombo devono essere utilizzati per garantire la temperatura minima e miglior fissaggio)

Refitting

1 applica flusso ai pad sulla scheda madre e una piccola quantità sopra l'ic

2 preriscaldare la scheda madre per circa 10 minuti a 220 degs

3 posizionare il ic in posizione sui pad della scheda madre ic deve essere orientata correttamente a questo punto

4 utilizzando un ugello 6 millimetri impostato 210 / 220deg e luogo minima portata d'aria la pistola ad aria calda direttamente sopra la ic a una distanza di circa 5 a 10 mm, i componenti esterni devono essere protetti da qualsiasi calore in ogni momento tempo di riflusso è 2 minuti e 30 secondi (vedi note sotto)

5 rimuovere il calore e permettere al MB raffreddare per circa. 5 minuti senza muoversi

Note importanti

Essere informati ci sono molte variabili coinvolte nella saldatura ad aria calda

MB = scheda madre IC = circuito integrato Tutte le temps e le durate sono basati su un sistema di reflow BGA aria calda pienamente funzionante

la maggior parte dei sistemi di BGA sul retailing mercato per meno di £ 399 hanno tolleranze ampie esempio l'indicatore può dire 200deg ma la tolleranza potrebbe essere> <10% quindi il calore prodotto può effettivamente essere nulla da 180deg a 220deg .in questo caso è fondamentale per calibrare il dispositivo prima.

La temperatura ambiente è di vitale importanza assicurarsi che la temperatura ambiente della stanza che si sta utilizzando sia all'interno del campo di 19deg a 21deg Le istruzioni di cui sopra sono a titolo indicativo e computabench declina ogni responsabilità per guasti o danni ai componenti causati da personale non addestrato

https://www.youtube.com/watch?v=rkMAltOVN4Y